

气派科技股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年，气派科技股份有限公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，秉持对全体股东高度负责的原则，依法合规、勤勉尽责地行使董事会职权，认真执行股东会各项决议，扎实推进董事会各项工作，持续提升公司治理水平，保障公司各项业务持续、稳健、高质量发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、公司 2025 年度生产经营情况

2025 年半导体行业走出超预期复苏行情，整体呈高增长、强分化、AI 驱动特征，周期明确进入需求复苏+主动补库存阶段，2025 年公司充分释放行业低周期积蓄的体系化势能，全方位激活组织活力、深化客户价值、筑牢质量根基、降本增效。报告期，公司营业收入实现增长，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期亏损减少。公司主要经营情况如下：

1、公司主要经营情况

报告期，公司实现营业收入 76,878.86 万元，较上年同期增加 10,222.61 万元，增长 15.34 %；归属上市公司股东的净利润为-7,538.40 万元，较上年同期亏损减少 2,672.97 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,657.72 万元，较上年同期亏损减少 3,454.64 万元。

2、加强新产品、新技术开发力度，持续丰富产品种类

报告期内，在集成电路封装测试方面，公司完成了 SOP、TSSOP 系列的高密度大矩阵封装技术的升级转换（低密度框架转高密度框架），转换率达 95% 以上，完成了 SOT89 系列的高密度大矩阵封装技术的固化并进入到大批量生产阶段，为公司继续在 SOT89 封测业务上持续保持竞争力保驾护航。完成了 LQFP10X10 BOM 考核和工艺验证、TSOT23-6Z 和镀镍锡工艺量产，成功立项了 FC QFN 先进封装项目并获得多家客户的合作、立项了高密度大矩阵的薄型 QFP 封装项目和 LQFP 封装项目。

在功率器件封装测试方面，TO252、TO220、TO263、TO247、PDFN56、PDFN33、TO220AB 等产品持续大批量生产并展开了扩线动作以扩大产能；基于PDFN33 封装的铝带产品工艺完成大批量生产验证，年出货量达到 1,000 万只；基于工业标准的 TO-247 封装的 SiC MOSFET 封装持续小批量交付；完成多批 PDFN56 铜夹产品的工程试制和小批量出货；完成了 TOLL 产品通线和全系列 BOM 的可靠性考核，目前已获得重要客户的认可；立项了基于 PDFN56 clip 封装的双面散热封装技术项目和用于 AI 算力芯片供电的 Dr.MOS 功率器件系统级封装测试项目。功率器件封测规模持续扩大，技术持续更新迭代。

报告期，公司申请了 34 项专利，其中发明专利 10 项；获得授权的专利 36 项，其中发明专利 6 项。

3、构建大客户“一企一策”管理，筑牢价值增长护城河

报告期，公司通过深入了解大客户的业务模式、行业特点以及潜在需求，提供量身定做的产品或服务包，包括但不限于定制化的产品功能、专属的服务，成立专门针对特定大客户的项目组，涵盖销售、技术、客服等多个职能部门，确保能够快速响应客户需求。建立健全的反馈机制，定期收集并分析来自大客户的评价与建议，据此不断改进自身的服务水平。从而与大客户建立更加稳固的合作关系，促进企业的价值增长。

4、推进成本精进

报告期，公司从生产效率、人力配置、流程优化、技术研发和材料替代等多方面进行成本优化和控制。在生产效率方面，在人力配置优化方面，根据各部门的实际需求和发展规划，重新评估岗位设置与人员编制，将生产量与直接人工数量进行挂钩，确保人力资源的最佳配置。在流程优化方面，针对现有业务流程进行全面审查，识别出瓶颈环节并加以改进，实现信息共享和实时沟通，大大缩短了项目周期。持续完善标准化操作流程，保证产品质量的一致性，同时也便于管理和监控。在技术研发方面，持续加大对研发的投入力度，致力于开发新技术、新产品，以满足市场不断变化的需求。如：持续推进高密度大矩阵引线框技术应用范围，在节省材料的同时提高生产效率。在材料替代方面，为应对材料价格上涨，公司通过多维度的材料和工艺验证，实现部分材料的国产替代。

5、锻造质量文化内核，夯实可持续发展根基

报告期，公司紧密围绕战略，全面升级质量管控体系，将质量文化深深植根于企业的基因之中。定期开展相关培训课程，不仅涵盖基础的质量管理知识，还包括最新的行业趋势和技术动态，帮助员工拓宽视野，提高解决问题的能力。持续审视现有业务流程，寻找可以简化或改进之处，从而减少错误发生的可能性，提高工作效率。建立有效的客户反馈渠道，及时收集并处理客户的建议和投诉信息，通过对客户需求的深入了解，能够更好地预测市场变化趋势，提前布局调整策略，满足甚至超越客户的期望值。

6、深化人才强企计划，激活组织创新动能

报告期，公司对组织架构进一步优化，调整部分臃肿机构和成员，并有初步成效。在人才引进方面，持续深化校园招聘，优化生源结构。报告期，成功从国内外重点高校引进数十名优秀应届毕业生，专业覆盖微电子、材料、机械、自动化等封测全工序所需领域。通过“新生力”三年培养工程的持续优化，为芯片设计协同、先进封装研发、智能产线运营等关键环节注入了新鲜血液，搭建起年龄结构与知识体系更为合理的新生代人才梯队。在员工培训方面，针对不同层级员工实施了系统性的培训与个性化培养方案，团队专业能力与综合素养全面提升。针对工艺瓶颈与设备效能提升的迫切需求，全年策划并实施工艺优化、精密设备运维、质量工具（如 SPC、FMEA）应用、自动化编程等专项技术培训 50 场，累计参训 1,114 人次。培训强调“训战结合”，超过 60% 的课程以生产线真实问题为课题，推动培训成果直接转化为生产效率与良率的提升。

二、2025 年度董事会的运行情况

（一）董事会尽责履职情况

2025 年公司召开了 6 次董事会会议、3 次股东（大）会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，所有的会议议案均获得通过和得到有效执行，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	第四届董事会第二十一	2025/4/24	《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

	次会议		<p>《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>《关于评估独立董事独立性的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于 2025 年公司及其控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案》</p> <p>《关于审议公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>《关于审议公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>《关于续聘公司 2025 年度审计机构和内控审计机构的议案》</p> <p>《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》</p> <p>《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>《关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》</p> <p>《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》</p> <p>《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>《关于 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
2	第四届董事会第二十二次会议	2025/7/17	<p>《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》</p> <p>《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》</p> <p>《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事》</p> <p>《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案事候选人的议案》</p>
3	第五届董事	2025/8/4	《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

	会第一次会议		《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于聘任公司审计部负责人的议案》
4	第五届董事会第二次会议	2025/8/11	《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
5	第五届董事会第三次会议	2025/8/14	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》 《关于提请公司股东会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 《关于设立 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》 《关于提请股东会同意认购对象免于发出要约的议案》 《关于提请择期召开临时股东会的议案》
6	第五届董事会第四次会议	2025/10/30	《关于 2025 年第三季度报告的议案》

（二）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《气派科技股份有限公司独立董

事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益，为董事会的科学决策提供了有效保障。

三、公司未来发展规划

2025年，全球半导体封测行业在AI算力爆发与国产替代加速的双重驱动下实现高质量发展，国内半导体封测行业也温和复苏。2026年，国内外AI基础设施建设将继续保持强劲态势，AI技术的广泛应用，从智能安防、智能医疗到自动驾驶、智能金融等各个领域，都对半导体芯片提出了更高的性能要求。无论是用于数据训练的GPU芯片，还是用于推理的ASIC芯片，市场需求都呈现出爆发式增长。同时，5G通信技术的进一步普及，也将带动万物互联的发展，使得各类智能终端设备对半导体的需求持续攀升。

2026年，公司将紧抓行业机遇，大力拓展自身业务规模，增强自身核心竞争力，提升公司市场占有率。

1. 深耕封装测试业务，拓展高附加值应用

虽然先进封装是封测行业增长的核心，但传统封装并不是落后的代名词，而是高可靠性、高性价比的代名词。传统封装是公司的基本盘，公司将继续深耕传统封装，拓展高附加值应用，逐步调整产品结构，实现营业收入和利润双增加。同时，时刻关注热门应用领域，加大先进封装技术的研发，为公司向先进封装发展储备力量。

2. 完善服务体系，提升客户体验

2026年，公司将继续完善客户服务体系，构建一个涵盖咨询、销售、研发、工艺、品质等人员的一站式服务平台，力求为客户提供无缝衔接的服务体验。与此同时，我们还将建立健全快速响应的客户反馈处理系统，及时解决客户遇到的问题。

3. 质量数字化升级，驱动质量管理迈向新高度

面向2026年，公司质量管理将锚定“零缺陷”愿景，以构建“端到端质量闭环”为核心，通过体系化升级与数字化创新，驱动质量管理迈向新高度。

一是，聚焦客户体验，攻坚核心质量痛点。公司将启动检验精度提升、专线

质量深度管理及错漏混专项治理等关键项目。通过建立质量异常分级管理机制与升级过程监控预警系统，致力于将客户声音（VOC）投诉量同比大幅削减，系统性根治突出质量问题。二是，推动数字化与智能化转型，提升管理能效。公司将持续推进人力与流程的优化，建立完善的报废与返工成本监控体系。重点引入AI视觉检测等先进技术，加速无纸化办公与供应商管理系统的数字化建设，以科技手段强化风险预警与全流程质量追溯能力，实现管控效能的跨越式提升。三是，筑牢人才与文化根基，构建全面质量生态。规划实施多层次人才培养项目，完善员工成长通道。通过打造特色质量激励品牌与知识竞赛等活动，持续深化全员质量意识。最终，通过落地14项重点改进措施，系统构建涵盖“三大体系、五大工具、六项机制”的立体化质量管理新格局，为公司战略目标的实现与行业领先地位的巩固提供不可或缺的品质保障。

4. 构建“适配性”人才体系

深化“青年英才加速器”项目，针对持续引进四年的、已成为公司中坚力量的青年群体，建立健全覆盖“任用、培养、识别、考核、评价、激励”的全流程管理体系。让完成加速培养的优秀青年人才，以更高比例进入关键技术专家、部门主管及经理等核心岗位，强力支撑干部队伍年轻化、专业化。

启动“高端研发生力军”计划，全年目标引进20余名硕士及以上学历毕业生，并与2-3所重点高校落地“校企联合培养研究生”项目，推行高校导师企业挂职、研究生入企攻关，实现前沿技术研究的超前布局。

打造“战略性技能赋能中心”，以大师工作室为核心，联合设备、工艺部门，开发系列认证课程，聚焦智能装备维护、大数据工艺分析等未来技能，全年计划新增高级工及以上技能人才40人，完成关键产线人才技能地图全覆盖。